



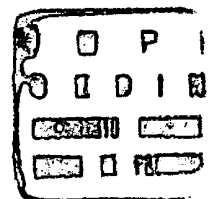
República Federativa do Brasil
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e do Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(11) (21) **PI 0106351-0 A**

(22) Data de Depósito: 14/12/2001
(43) Data de Publicação: 17/09/2002
(RPI 1654)



(51) Int. Cl.⁷ :
C08L 1/00
C08K 3/20



(54) Título: **MATERIAL
COMPÓSITO: TERMOPLÁSTICO, FIBRA VEGETAL
E/OU PÓ DE MADEIRA E CERÂMICA**

(71) Depositante(s): Fapesp - Fundação De Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (BR/SP)

(72) Inventor(es): Milton Ferreira De Souza, Washington Luiz
Esteves Magalhães, José Augusto Marcondes Agnelli

(74) Procurador: Márcio Loreti

(57) Resumo: "MATERIAL COMPÓSITO: TERMOPLÁSTICO - FIBRA VEGETAL E/OU PÓ DE MADEIRA E CERÂMICA. A presente invenção refere-se a materiais compósitos: termoplástico, fibra vegetal e/ou pó de madeira e cerâmica. A fibra vegetal lignocelulósica, preferencialmente fibras ou pó de madeira, são misturadas com polímeros termoplásticos, preferencialmente poliéteres, poliésteres ou náilons. Esta mistura é feita na temperatura de fusão do polímero, ou um pouco maior, mas deve ser inferior a temperatura de degradação das fibras orgânicas. A fibra vegetal ou o pó de madeira são misturados diretamente com o polímero termoplástico, preferencialmente poliacetal. A porcentagem em peso de fibra varia entre 20 e 80%. A mistura apresenta alta resistência a compressão além de excelente estabilidade térmica comparada ao polímero isoladamente. A gama de compósitos assim preparados encontra aplicação nas indústrias que empregam a madeira maciça e pode substituir as resinas de acetais na fabricação de artefatos para a indústria em geral e em particular para as de autopeças. A excepcional capacidade de adesão do poliacetal à madeira permite a colagem madeira-madeira empregando-se a técnica de aquecimento elétrico do compósito polímero-pó condutor elétrico, por exemplo por RF, corrente elétrica, etc. O pó cerâmico, de preferência TiO₂, tem por finalidades: agir como catalisador na decomposição do formaldeído, efeito estético, aumento da dureza superficial, efeito antichama e proteção contra U.V..



BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais

Instituto Nacional da

Propriedade Industrial

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Consulta à Base de Dados do INPI

[Início | Ajuda?]

» Consultar por: [Base Patentes](#) | [Finalizar Sessão](#)

1/1

Depósito de pedido nacional de Patente

- (21) Nº do Pedido: **PI 0106351-0 A2**
- (22) Data do Depósito: 14/12/2001
- (43) Data da Publicação: 17/09/2002
- (47) Data da Concessão: -
- (51) Classificação - IntCL: **C08L 1/00 ; C08K 3/20**
- (54) Título: MATERIAL COMPÓSITO:TERMOPLÁSTICO,FIBRA VEGETAL E/OU PÓ DE MADEIRA E CERÂMICA
- "MATERIAL COMPÓSITO: TERMOPLÁSTICO - FIBRA VEGETAL E/OU PÓ DE MADEIRA E CERÂMICA. A presente invenção refere-se a materiais compósitos: termoplástico, fibra vegetal e/ou pó de madeira e cerâmica. A fibra vegetal lignocelulósica, preferencialmente fibras ou pó de madeira, são misturadas com polímeros termoplásticos, preferencialmente poliésteres, poliésteres ou náilons. Esta mistura é feita na temperatura de fusão do polímero, ou um pouco maior, mas deve ser inferior a temperatura de degradação das fibras orgânicas. A fibra vegetal ou o pó de madeira são misturados diretamente com o polímero termoplástico, preferencialmente poliacetal. A porcentagem em peso de fibra
- (57) Resumo: varia entre 20 e 80%. A mistura apresenta alta resistência a compressão além de excelente estabilidade térmica comparada ao polímero isoladamente. A gama de compósitos assim preparados encontra aplicação nas indústrias que empregam a madeira maciça e pode substituir as resinas de acetais na fabricação de artefatos para a indústria em geral e em particular para as de autopeças. A excepcional capacidade de adesão do poliacetal à madeira permite a colagem madeira-madeira empregando-se a técnica de aquecimento elétrico do compósito polímero-pó condutor elétrico, por exemplo por RF, corrente elétrica, etc. O pó cerâmico, de preferência TiO₂, tem por finalidades: agir como catalisador na decomposição do formaldeído, efeito estético, aumento da dureza superficial, efeito antichama e proteção contra U.V..
- (71) Nome do Depositante: Fapesp - Fundação De Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (BR/SP) / Universidade de São Paulo - USP (BR/SP)
- (72) Nome do Inventor: Milton Ferreira De Souza / Washington Luiz Esteves Magalhães / José Augusto Marcondes Agnelli
- (74) Nome do Procurador: Maria Aparecida de Souza

Petições ?

Pgo	Protocolo	Data	Imagens	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	800090200201	25/11/2009	- - -	220	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP		-
✓	800090016854	02/02/2009	- - -	220	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP		-
✓	018080039385	24/06/2008	- - -	208	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP		-
✓	800080090301	23/06/2008	- - -	221	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP		-
✓	800080090302	23/06/2008	- - -	221	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP		-
✓	018080036125	11/06/2008	- - -	249	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP		-
✓	020060019304	10/02/2006	- - -	220	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo		-

Publicações ?

RPI	Data RPI	Despacho	Img	Complemento do Despacho
2080	16/11/2010	9.2.4	-	- MANTIDO O INDEFERIMENTO UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL.
2055	25/05/2010	9.2	-	- Indefero o pedido de acordo com o artigo 8º da LPI.
2020	22/09/2009	7.1	-	-
1975	11/11/2008	25.1	-	- Transferido parte dos Direitos de: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP
1654	17/09/2002	3.2	-	-
1624	19/02/2002	2.1	-	-

Dados atualizados até **04/10/2016** - Nº da Revista: **2387****Documentos Publicados**

RPI 1654

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910 | Rua São Bento, 1 - Centro - RJ - CEP: 20090-010

